臺灣高等法院臺南分院民事判決

108年度上字第5號

上　訴　人　安集科技股份有限公司
法定代理人　黃國棟
訴訟代理人　黃紹文律師
　　黃溫信律師
被 上訴 人　中華電信股份有限公司
法定代理人　謝繼茂
訴訟代理人　吳光陸律師
　　郭乃瑩律師
被 上訴 人　鋌鑫科技股份有限公司
法定代理人　陳印生（原名：陳鋌鑫）

上列當事人間請求第三人異議之訴等事件，上訴人對於中華民國107年11月7日臺灣臺南地方法院第一審判決（107年度訴字第560號）提起上訴，本院於109年4月16日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人中華電信股份有限公司應將如附表三所示半導體模組773片返還上訴人。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人中華電信股份有限公司負擔五分之四，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受其訴訟以前當然停止；第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明；聲明承受訴訟，應提出書狀於受訴法院，民事訴訟法第170條、第175條第1項、第176條定有明文。本件起訴時被上訴人中華電信股份有限公司（下稱中華電信公司）法定代理人原為鄭優，於本

院審理期間之民國（下同）108年5月20日變更為謝繼茂，業據其提出中華電信公司變更登記表、委任狀為證，謝繼茂具狀聲明承受訴訟（見本院卷一第437-449頁），應予准許。

二、被上訴人鋌鑫科技股份有限公司（下稱鋌鑫公司）未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面

一、上訴人主張：(一)上訴人提起第三人異議之訴應屬合法：緣中華電信公司以曾為出賣人與被上訴人鋌鑫公司訂有太陽能光電模組（又稱半導體模組，下稱半導體模組）之動產擔保附條件買賣交易，交易數量為4075片（如附表一所示），因鋌鑫公司未履約，乃聲請法院聲請取回如附表一所示動產擔保交易標的物，由原審法院民事執行處（下稱執行法院）以107年度司執字第25750號交付機器設備執行事件受理（下稱系爭執行事件）。因中華電信公司主張附表一所示標的物係放置在上訴人廠區即臺南市○○區○○○路00號內（下稱上訴人廠區），故會同法院執行處人員於107年4月2日至上訴人廠區執行，惟執行法院人員僅表示其受中華電信公司引導前來取回附表一所示標的物，並未告知執行之特定標的物為何，亦未於執行筆錄附表記載明確，中華電信公司亦僅表示欲取回之標的物係其向訴外人喬杰科技股份有限公司（後改名為喬衍科技股份有限公司，下仍稱喬杰公司）購買並售予鋌鑫公司之半導體模組，而因鋌鑫公司曾於105年4月間引介喬杰公司向伊公司購買半導體模組，並由鋌鑫公司為相關交易之保證人，故伊公司員工依執行法院及中華電信公司上開陳述查核資料後，始向執行法院說明半導體模組尚有341片在伊廠區內，且當場表示該批半導體模組係105年5月31日出售與喬杰公司，但不知設有動產擔保抵押，因喬杰公司僅給付部分貨款，廠區內的半導體模組係伊公司於105年10月17日向喬杰公司買回之產品，執行法院遂以該執行標的物與附表一所示動產擔保交易標的物是否同一尚未確定，未予執行

，伊公司則繼續占有該341片半導體模組，則因該模組將來是否會受執行仍屬未定，伊當日並無提起第三人異議之訴之程序利益。嗣中華電信公司會同執行法院於107年4月9日再次前來伊廠區，主張取回現場存放如附表三所示773片半導體模組時，伊仍主張該批半導體模組早已自喬杰公司買回並取得所有權，廠內並無附表一所示中華電信公司出售鋌鑫公司之半導體模組，是上訴人與中華電信公司對於附表三所示執行標的物否為中華電信公司與鋌鑫公司間之附條件買賣標的物已有爭議，惟執行司法事務官為形式審查後，認定附表三所示執行標的物包含在附表一所示附條件買賣標的物內，准由中華電信公司取回，並告知伊主張係執行標的物所有權人，涉及實體法上權利義務關係，非執行法院所得審究，應由伊另行提起第三人異議之訴，伊旋於三日內整理相關資料提起本件訴訟，則附表三所示半導體模組雖經執行法院解除伊之占有並交付中華電信公司，但執行取回的狀態仍在持續中，伊自有強制執行法第15條之異議權，得撤銷已執行之強制執行程序，回復原有狀態。又中華電信公司自陳附表三所示執行標的物仍存放在其位於臺中工業區之料庫內，則本件執行程序僅係占有狀態之變更，執行標的物之事實及法律狀態則未改變，伊請求撤銷執行程序重新如附表三所示半導體模組之占有以保障所有權，自符合第三人異議之訴之立法意旨。(二)附表三所示執行標的物係上訴人所有：附表三所示半導體模組係伊生產製造，雖曾出售並交付喬杰公司，但伊已於105年10月17日買回並入庫，較中華電信公司106年1月12日為附條件買賣登記更早，伊為附表三所示執行標的物之所有權人並占有甚明。中華電信公司雖主張其於105年4月21日即完成驗收附表一所示動產擔保交易標的物，但當時附表三所示執行標的物之半導體模組還在生產階段尚未完成及備貨，中華電信公司竟主張有在新竹市及臺南市另一廠區完成驗收交貨，客觀上顯不可能亦不實在。且鋌鑫公司如有購買半導體模組之必要，根本不需要與中華電信公司訂購，其大

可直接向喬杰公司或向伊購買以節省成本，但鋌鑫公司卻違反交易常例，由喬杰公司出售半導體模組予中華電信公司，鋌鑫公司再於同一時間向中華電信公司購買，一買一賣之間，鋌鑫公司購入成本增加，中華電信公司獲得價差利益，實不合常理，況鋌鑫公司本為太陽能光電半導體模組業者，中華電信公司之供貨來源卻係鋌鑫公司所主導控制之喬杰公司，此一交易型態顯非財產交易，本質上實係假交易、真融資，由中華電信公司賺取利差（兩筆交易之差額依卷內資料顯示為新台幣《下同》1,489,672元）。(三)系爭模組與附條件買賣契約之標的不具同一性：中華電信公司有義務說明如何特定執行標的，依其主張及提出之動產擔保登記設定契約書，該標的內容係於105年4月21日驗收，由伊公司製造，出廠期日為105年3月之半導體模組，然而附表三所示執行標的物之半導體模組之工單日期均為105年4月或5月，顯與中華電信公司主張附表一所示附條件買賣標的物係105年3月出產製造者不同，伊公司係基於尊重配合執行法院之立場，才會以電腦查核出售與喬杰公司之半導體模組之特定序號，但當時即表明從不知有設定動產擔保情事，且清楚敘明該批模組因喬杰公司積欠貨款，已由伊於105年10月17日購回，該附表三所示執行標的物之半導體模組固係伊出售予喬杰公司，但中華電信公司出售鋌鑫公司之附條件買賣標的物為何，應依附條件買賣標的記載之內容來特定之，兩者本非當然劃上等號，中華電信公司在本件執行及訴訟中，泛稱伊出售予喬杰公司如附表三所示半導體模組即為附表一所示附條件買賣標的物，實不足採。(四)縱認第三人異議之訴不合法，伊亦主張民法第948條、第767條所有物返還請求權：退一步言，本件縱不考慮中華電信公司對於附條件買賣之主張及登記內容（即105年3月出廠，105年4月21日驗收之模組），附表三所示執行標的物之半導體模組早於附表一所示附條件買賣動產擔保登記公示之前，即已由伊於105年10月間購買取得所有權，伊係善意第三人，依民法第948條之規定取得附表三

所示執行標的物之半導體模組所有權，本件執行程序已侵害伊之權益，中華電信公司應將附表三所示執行標的物之半導體模組返還予伊。原審未就上訴人此部分聲明調查以為准駁，逕以本件強制執行程序業已終結，駁回上訴人全部之訴，顯有重大違誤，為此，提起上訴，並聲明：1.原判決廢棄。2.臺灣臺南地方法院107年度司執字第25750號執行事件對附表三所示之太陽能光電半導體模組之強制執行程序應予撤銷。3.被上訴人中華電信公司應將附表三所示之太陽能光電半導體模組返還上訴人。4.第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

二、被上訴人中華電信公司則以：(一)上訴人提起本件訴訟並不合法：伊係依動產擔保交易法第28條第1項第1款、第30條準用第17條第2項之規定行使附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物之取回權，並經執行法院於107年4月9日強制執行後，取回占有，伊取回後執行程序即告終結，毋庸另為其他執行行為，上訴人遲於107年4月12日始提起本件第三人異議之訴，係於強制執行程序終結後方提起訴訟，已逾強制執行法第15條法定不變期間之規定，上訴人請求撤銷執行程序自不合法，應予駁回。(二)縱認本件第三人異議之訴並未逾期，然附表三所示執行標的物之半導體模組確為伊與鋌鑫公司間如附表一所示之附條件買賣標的物，上訴人本於所有權提起第三人異議之訴為無理由。伊與鋌鑫公司簽訂太陽能模組專案契約後，伊即向喬杰公司購買包括附表三所示執行標的物在內之半導體模組共計6,845片，再將之出售予鋌鑫公司，並與鋌鑫公司訂定附條件買賣契約，且已會同喬杰公司、鋌鑫公司至上訴人廠區進行三方驗收，伊於驗收當日即將出售鋌鑫公司之半導體模組全數交付鋌鑫公司，嗣因鋌鑫公司未清償價款，伊遂於107年3月16日具狀聲請強制執行，執行法院於107年4月2至現場執行時，上訴人員工即表示現場之半導體模組係出售予喬杰公司者，因喬杰公司未給付貨款，故上訴人將出售喬杰公司之半導體模組其中3,971片拖回

，廠區內僅剩314片，經司法事務官當場命上訴人員工協同伊檢視動產現況及數量後，諭知改期於107年4月9日再至上訴人廠區取回動產，該日（107年4月2日）執行筆錄並經上訴人法定代理人及法務人員簽名確認；嗣再次執行（即107年4月9日）時，上訴人復爭執附表三所示半導體模組早於伊與鋌鑫公司辦理附條件買賣契約登記前，即由其向喬杰公司買回，經司法事務官確認上訴人與喬杰公司間就相同規格、型式、數量之買賣契約僅有一筆後，司法事務官即諭知依雙方所稱內容，附表三所示773片半導體模組應為附表一所示伊附條件買賣予鋌鑫公司之動產無誤，執行筆錄亦經上訴人訴訟代理人簽名確認，顯見附表三所示半導體模組即係喬杰公司向上訴人購買後再出售予伊，伊再以附條件買賣之方式出售予鋌鑫公司，上訴人自非附表三所示半導體模組之所有權人，且附表三所示半導體模組之規格、型式、數量均與附表一所示附條件買賣登記契約之標的物相符，伊自得認定附表三所示動產為附表一所示動產中之773片。上訴人雖提出提貨單、出廠放行單、廠內半成品製造命令等，但伊均否認該等文件之真正，蓋該等文件為上訴人內部文件，是否為臨訟杜撰、與本件訴訟有無關連？並非無疑，上訴人迄未提出其他事證證明伊為附表三所示執行標的物之半導體模組之所有權人，其主張及陳述亦甚模糊，更有自相矛盾之情，其請求伊返還附表三所示半導體模組於法無據，原審判決所為認定並無違誤，上訴人之上訴為無理由等語，資為抗辯。並答辯聲明：1.上訴駁回。2.第二審訴訟費用由上訴人負擔。

三、被上訴人鋌鑫公司經合法通知，未於言詞辯論期日到場，復未提出任何書狀作何聲明或陳述。

四、兩造不爭執事項與爭執事項

(一)兩造不爭執事項

1.中華電信公司於107年3月19日具狀向原審法院聲請依動產擔保交易法第28條、第30條準用第17條規定，取回如附表一所示之動產，經原審法院民事執行處以系爭交付機器設備事件

受理後，於107年4月9日在上訴人廠區將附表三所示之半導體模組取交予中華電信公司。

2.原審法院民事執行處於107年4月2日會同中華電信公司代理人至上訴人廠區檢視附表三所示執行標的物現況時，已將中華電信公司聲請取回附表一所示附條件買賣動產擔保標的物乙節告知上訴人，並經上訴人法定代理人於該日執行筆錄上簽名（司執卷第50頁）。

3.上訴人於107年4月12日依強制執行法第15條規定提起本件訴訟，並依所有物返還請求權主張中華電信公司應將附表三所示半導體模組返還上訴人（原審卷第15、21頁）。

(二)兩造爭執事項

1.上訴人提起本件第三人異議之訴，是否符合強制執行法第15條「強制執行終結前」之要件？

2.附表三所示執行標的物之動產是否即被上訴人中華電信公司主張附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物之動產其中之773片？

3.上訴人就附表三所示執行標的物有無足以排除強制執行之權利存在？

4.上訴人主張其為附表三所示動產之所有權人，有無理由？

5.上訴人依民法第767條第1項前段規定，請求被上訴人中華電信公司返還附表三所示之動產，有無理由？

五、得心證之理由

(一)上訴人依強制執行法第15條提起第三人異議之訴，請求撤銷系爭執行事件之執行程序，不應准許。

1.按第三人就執行標的物有足以排除強制執行之權利者，得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴，強制執行法第15條前段定有明文。是提起第三人異議之訴，應於強制執行程序終結前，方得為之。本件上訴人提起第三人異議之訴，主張其為附表三所示執行標的物之所有權人，請求撤銷系爭執行程序等語，惟中華電信公司否認，並以前揭情詞置辨。經查：

⑴中華電信公司依動產擔保交易法第28條、第30條準用同法第17條規定，聲請執行法院強制取回附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物，業經執行法院於107年4月9日在上訴人廠區當場將如附表三所示執行標的物取交中華電信公司乙節，為兩造所不爭執，並經本院調閱系爭執行事件全卷查明無訛。系爭執行事件之執行名義係取回附表一所示之動產，屬物之交付請求權，於執行法院將執行標的物交付執行債權人即中華電信公司後，系爭執行事件之執行程序即已終結。

⑵上訴人雖辯稱107年4月2日並未實施執行，伊於當日並無提起第三人異議之訴之程序利益，嗣於107年4月9日始前來執行取回動產程序，伊旋於三日內整理相關資料提起本件訴訟，且執行法院雖解除伊之占有，將動產交付中華電信公司，但執行取回狀態仍持續中，伊自有強制執行法第15條之異議權云云，然執行法院於107年4月9日解除上訴人對於附表三執行標的物之占有，將動產交付債權人中華電信公司，已實現執行名義所示由債權人取得占有抵押動產之內容，而終結交付動產之執行程序，上訴人主張執行程序尚未終結，並無可採，況執行法院於107年4月2日前往上訴人廠區時，雖未實際取回執行標的物，然依當日執行筆錄所示，業已告知欲執行取回附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物意旨，並於協同上訴人公司人員檢視現場所見之半導體模組，顯已實施執行行為，上訴人既主張其為所有權人，已得以提起第三人異議之訴，然其係在107年4月9日執行法院解除上訴人之占有，將動產交付中華電信公司終結執行程序後，始於同年4月12日提起本件第三人異議之訴，顯已逾強制執行法第15條規定得提起第三人異議之訴之期間，於法無據。

2.綜上，上訴人提起本件第三人異議之訴，不符合強制執行法第15條規定，是其依強制執行法第15條規定請求撤銷系爭執行事件取回附表三所示執行標的物之執行程序，於法不合，

不應准許。

(二)中華電信公司與鋌鑫公司簽訂買賣契約、設定附條件買賣動產擔保交易登記及聲請強制執行取回過程

1.經查，中華電信公司於105年4月7日向鋌鑫公司提出半導體模組報價單（規格、數量為：⑴230WP：293片，⑵240WP：1712片，⑶250WP：6845片），嗣於同年4月就上開報價單之商品項目及數量，與鋌鑫公司簽訂專案契約書（專案名稱：太陽能發電模組設備服務專案，契約編號《專案編號：WPCD005062》），約定總價金為43,846,068元（含稅），並以上開報價單作為專案契約書附件（見原審卷第115-123頁，下稱鋌鑫公司專案契約）。同年4月20日中華電信公司另與喬杰公司簽訂專案契約書，約定中華電信公司提供鋌鑫公司之「太陽能發電模組設備服務專案」，由喬杰公司提供本專案產品及服務，擔任中華電信公司專案廠商，產品項目、數量另以「承商交貨簽收單」作為附件，專案商品項目、數量與前述鋌鑫公司專案契約相同，惟契約總價款約定為42,356,496元（含稅）（見原審卷第95-109頁，下稱喬杰公司專案契約）。中華電信公司旋於翌日（即105年4月21日）會同鋌鑫公司、喬杰公司人員，在台南市○○區○○○路00號辦理喬杰公司專案契約與鋌鑫公司專案契約之驗收、交貨事宜（中華電信公司自認驗收交貨文書所記載的交貨地點台南市○○區○○○路00號查無此地址，應係誤載，然陳述驗收交貨地點為上訴人廠區，見本院卷二第32頁），有同日中華電信公司與喬杰公司竣驗驗收紀錄、承商交貨簽收單（見原審卷第111、112頁），中華電信公司與鋌鑫公司之驗收簽報單、交貨簽收單（見司執卷第25、27頁）及中華電信公司提出專案契約編號WPCD005062工程施工日誌、驗收照片、中華電信公司員工公出差簽報系統資料在卷可稽（見原審卷第165頁、第281-305頁），中華電信公司並開出金額43,846,068元之發票（買受人：鋌鑫公司，見司執卷第29頁），上開105年4月21日驗收、交貨相關文書雖未詳載驗收交貨之半導體模組

全部序列號，然由驗收照片中可見該次驗收之商品型式為Model Type：AJP-M000 000W，其中有2箱即箱號C/N：CT000 00000-000、箱號C/N0 0000000-000，每箱各裝有13片，外箱有標示每片模組之商品序列號如附表二所示（見原審卷第287-291頁）。上訴人對於中華電信公司主張照片拍攝時間105年4月21日，雖有爭執，但自認拍照地點確是上訴人廠區及照片中有上訴人公司人員在場（見本院卷二第32-33、114頁）。復經本院去電詢問上訴人公司人員半導體序列號之意義，據上訴人公司人員李柏威答覆：「Serial No為序列號，每一片太陽能模組均有一組序列號，不會重覆，可以說是產品的生產履歷」、「本公司出產的每一片太陽能模組都有一組獨立的序列號，因此具有確認產品流向的功能，並非不具意義的流水號」等語（見本院卷一第433-434頁），兩造對此並未爭執，堪認每片太陽能半導體模組均有一組獨立序列號，應無疑義。

2.中華電信公司於106年1月12日將鋌鑫公司專案契約（契約編號WPCD005062），其中如附表一所示之半導體模組（250WP）4075片（所在地址：臺南市○○區○○○路00號即上訴人廠區）另簽訂附件買賣契約書，同日向臺南市政府申請動產擔保交易（附條件買賣）登記，經臺南市政府於106年1月25日核准發給登記證明書（府經工商附字第001139號）（見司執卷第17-23頁，原審卷第45-49頁）。其後，因鋌鑫公司積欠買賣價金，中華電信公司遂向執行法院聲請強制執行，請求取回附表一所示附條件買賣之動產，中華電信公司會同執行法院人員於107年4月2日前往上訴人廠區，由司法事務官向上訴人公司人員說明附表一所示動產已設定動產擔保予債權人中華電信公司及債權人聲請取回意旨，雖當日未實施取回之執行行為，然在場上訴人公司人員提出發票，表示發票憑證之動產前於105年5月31日出售喬杰公司，因喬杰公司僅給付部分貨款，上訴人公司遂於105年10月17日向喬杰公司買回3971片（以貨抵款），部分貨品已出售其他廠商，現只

剩下314片等語，當日並未實施執行，經執行法院改期於107年4月9日再前往執行時，上訴人公司人員與代理人仍表示就其向喬杰公司買回之3971片半導體模組為善意取得所有權之人，債權人（指中華電信公司）與債務人（即鋌鑫公司）主張附條件買賣標的形式上無從特定是上訴人向喬杰公司買回之模組，然經司法事務官詢問上訴人與喬杰公司間就附表一所示規格、型式、數量之買賣契約是否僅有105年5月31日之一筆交易，經上訴人公司人員確認表示無誤後，遂將現場773片半導體模組（如附表三所示）由中華電信公司取回而終結執行程序等情，有107年4月2日、同年4月9日執行筆錄附於系爭執行卷，並經本院依職權調取系爭執行事件卷宗查閱無訛。本院前請中華電信公司陳報107年4月9日執行取回之半導體模組序列號及數量，業據中華電信公司於108年4月29日具狀陳報取回之箱號、數量，共計32箱，合計773片，並將每箱外標示之半導體模組編號拍照存卷（見本院卷一第225-351頁），所標示之箱號及半導體模組編號詳如附表三所示。

(三)上訴人與喬杰公司之交易過程

1.上訴人主張其為太陽能光電半導體模組製造商，先前係出售半導體模組予鋌鑫公司，嗣經鋌鑫公司負責人陳鋌鑫告知其另設喬杰公司，上訴人乃同意出售太陽能光電半導體模組予喬杰公司，模組之電池由鋌鑫公司提供，喬杰公司於105年4月7日下訂購單，上訴人於105年4月11日與喬杰公司簽訂採購契約書（契約編號：0000000000），出售太陽能模組4075片予喬杰公司（產品名稱：(6*10)Poly Solar Module Cell：3 BB，AJP-M000-000W；AJP-LABLE:250W，數量4075片），金額總計18,920,633元（含5%營業稅），業據上訴人提出訂購單（PROFORMA INVOICE、PI No：0000-00000000000、M660 Solar Modle 4075pcs Total Amount:18,920,633）、採購契約書附卷可證（見原審卷第29-33頁、第189頁）。嗣因鋌鑫公司提供之電池品質不良，經上訴人品管權責人員判

定拒收，其後上訴人與喬杰公司簽定採購契約增補協定，上訴人不負責此4075片代工太陽能模組之10年保固責任與25年發電效能保固責任，買方（即喬杰公司）與賣方（即上訴人）雙方同意刪除採購契約書第11條品質保證期間與第12條驗收及品質異議所有條款，由上訴人出具產品異常通知單，並以前述採購契約書增補協定作為附件，上訴人即陸續自105年4月27日、同年5月11日、同年5月18日出具廠內半成品製造命令，內容如下：⑴開單日期：105年4月27日、備註：BG000000-BG055793，⑵開單日期：105年4月27日、備註：BG000000-BG056293，⑶開單日期：105年5月11日、備註：BG000000-BG065981，⑷開單日期：105年5月11日、備註：BG000000-000000，⑸開單日期：105年5月18日、備註：BG000000-BG070034，⑹開單日期：105年5月18日、備註：BG000000-BG070514，生產廠別均記載為「M2 安集二廠」，有上訴人提出原物料檢驗紀錄表4份、進貨驗收單、產品異常通知單、採購契約書增補協定各1份及廠內半成品製造命令6紙附卷為憑（見原審卷第251-268頁）。而就附表三所示773片執行標的物，上訴人另陳報工單資料（見本院卷一第473-492頁），該工單資料併列產品規格、箱號、序列號、工單號碼、生產訂單、裝箱工令備註欄等，該773片半導體模組之序列號（Serial No.）如附表三所示，Moudle No.欄前段均記載AJP-M660，工單號碼分別為105年4月27日、同年5月11日填製之00000000000、00000000000、00000000000、00000000000號工單號碼（即原審卷第263-266頁所示之廠內半成品製造命令），裝箱工令備註欄前段均記載M000-000W。

2.上開上訴人出售喬杰公司之4075片半導體模組原定105年5月31日出貨，前經上訴人公司業務張閩軒以電子郵件聯絡喬杰公司安排出貨事宜，因喬杰公司無法如期安排出貨，於105年5月31日出具延遲交貨通知予上訴人，並於通知上載明委請上訴人暫代保管該批產品，實際交貨日期將再行通知等語，此有上訴人提出張閩軒與喬杰公司聯絡出貨之105年5月25

日、同年5月31日、同年6月2日電子郵件及喬杰公司出具之延遲交貨通知在卷可證（見原審卷第191、323頁）。

3.上訴人主張其出售喬杰公司之上開半導體模組已製造完成並於105年5月31日備貨，因喬杰公司無法如期安排出貨，依喬杰公司通知，於105年6月22、23日將半導體模組運送指定之台中市○○區○村路000號倉庫，但上訴人交貨後，喬杰公司未依契約如期於105年7月22日付款，雙方乃約定先由上訴人將半導體模組取回保管，而於同年7月25、26日委由貨運公司載回上訴人之台南市倉庫等情，業據提出上訴人公司提貨單2紙（出貨日期：105年6月22日、M660 Solar Module 2080片；105年6月23日、M660 Solar Module 1995片，客戶名稱均為喬杰公司）、105年7月25、26日貨運公司收據6紙附卷（見本院卷一第133、135頁，原審卷第35-39頁）。又上訴人與喬杰公司於105年8月5日簽訂協議書，約定喬杰公司自105年8月8日起至同年12月31日之付款時程，並應支付貨品寄存上訴人倉庫之倉租費，然迄至105年10月，喬杰公司僅支付第1期款500,000元，即無力再支付其餘款項，雙方乃約定由上訴人購回該批出售之半導體模組，喬杰公司已支付之500,000元扣抵其中104片，並扣除價跌損失後，約定購回金額為11,912,613元，由喬杰公司開立發票（發票日期：105年10月17日、金額含稅11,912,613元）向上訴人請款，業據上訴人提出上訴人與喬杰公司105年8月5日協議書、喬杰公司開立之發票各1紙及上訴人公司105年10月21日、同年10月27、28日電子郵件附卷為證（見原審卷第41、43頁、第217頁，本院卷一第395頁）。因上訴人係以跌價購回，差額6,008,020元仍應由喬杰公司給付上訴人，此部分由鋌鑫公司於106年3月22日書立聲明書，依聲明書之記載簽發支票9紙（面額合計6,008,020元）予上訴人以為擔保，並由上訴與喬杰公司、鋌鑫公司書立三方聲明書，上訴人退還鋌鑫公司原簽發面額18,920,633之支票（即擔保原訂購單PI No:0000-00000000000、價金18,920,633元），亦據上訴人提出該

三方聲明書、鋌鑫公司106年3月22日聲明書及鋌鑫公司取回面額18,920,633元支票之字據1紙附卷（見原審卷第219、221、321頁），上訴人復於原審以107年8月30日民事言詞辯論狀主張鋌鑫公司上開9紙支票仍有第5-9期面額合計3,508,020元尚未給付（見原審卷第211、213頁）。

4.據上，上訴人於105年4月11日出售喬杰公司之4075片半導體模組，既因喬杰公司之遲誤，無法於約定之105年5月31日交貨，雖經雙方合意延展交貨時間，因喬杰公司未依約給付價金，而由上訴人於105年10月17日以11,912,613元買回，且取回其中3971片，自已因買回而取得該3971片半導體模組之所有權，而上訴人係在此之後之106年1月12日始與鋌鑫公司簽訂附條件買賣契約且設定動產擔保交易登記，則縱認附表三所示執行標的物之半導體模組即附表一所示系爭動產擔保交易標的物，上訴人於動產擔保交易登記前已善意取得動產所有權，自不受嗣後登記之動產擔保交易效力所拘束。

5.中華電信公司雖否認上訴人所提出上述關於附表三所示半導體模組產品製造流程、電腦製程等文書之真正，辯稱：該等文書均屬上訴人公司內部文件，無法證明其真正云云（本院卷二第33頁），惟查：

⑴上訴人主張其生產之太陽能半導體模組均編有序列號，生產產製時間可參每片模組鋁框上所貼14碼序號可資比對，序號前六碼分別標示生產廠房（1、2碼）、西曆年末二位（3、4碼）、開工製造令月份（5、6碼），上訴人公司生產係採用必利得資訊之MES系統，製造前會先發製造命令，登載發單日期、生產廠別、數量，系統會產生產品8碼流水號，生產製造完成後每片模組要進行檢測，每檢測一片前先刷一個流水號，並將檢測結果存入此流水號模組之資料庫內，檢測完成時，系統會抓取產生該流水號製造令之生產廠房、年份、月份資料，輯成14碼之產品序號列印成條碼，貼在該檢測之模組側框上，以中華電信公司提出三方驗收交貨照片中之序號M21601BG002151、M21601BG00

2156為例（見原審卷第283號照片，即附表二所示），其中M2代表生產工廠，16代表西曆生產年，01代表製造生產月，其餘8碼則為流水號等語，雖中華電信公司就附表三所示執行標的物因擔心開箱後影響價格，迄未同意實地勘驗逐一開箱清點，無從調查各箱內之半導體模組側框序列號，然中華電信公司曾提出其會同喬杰公司、鋌鑫公司驗收、交貨之喬杰公司、鋌鑫公司專案契約之半導體模組照片，當時就其中一箱模組有拆箱查看，就箱內堆疊的13片模組拍照（見原審卷第283頁），13片模組側框各有電腦條碼與上下2組編號，上方編號部分，除前2碼英文字外，其後有14碼混合英文與數字編號，該13片鋁框除最上方4片編號模糊難以辨識外，其餘9片中段編號可辨識均為「M21601」，後8碼則均為BG再加上6個不同數字，電腦條碼下方則是重覆BG加其後的6個數字，核與上訴人主張每片模組側框編號組成方式相符，參以兩造並未爭執上訴人公司人員李柏威所述：每一片太陽能模組都有一組獨立的序列號，不會重覆，是產品的生產履歷，具有確認產品流向的功能等語，對照上訴人提出附表三所示執行標的物之廠內半成品製造命令均有註記生產廠別：M2安集二廠，備註欄記載BG加6個數字（見原審卷第263-268頁），並與附表二所示中華電信公司提出驗收交貨照片中所見半導體模組箱號上記載之8碼序列號（即BG加6個數字）相符，堪認上訴人主張每片半導體模組製程均依生產工廠、西曆生產年、生產月及流水號輯成14碼之產品序列號，尚非無據，而可採信。

⑵再參105年4月間上訴人因鋌鑫公司提供之電池有瑕疵，而與喬杰公司另訂增補協定，約定解除上訴人保固與發電效能保固期間責任，所提出之原物料檢驗紀錄表4紙、進貨驗收單，分別記載各次檢驗之量測名稱、規範值、實測值、檢驗結果，備註欄則記載各次檢驗之瑕疵內容，至為具體詳細，並經審核、品管員等權責人員記載日期及核章（

見原審卷第251-255頁），顯非事後臨訟杜撰之文書，堪認為真正。

⑶又上訴人主張因喬杰公司遲延而無法於約定之105年5月31日交貨，經延展交貨時間，依喬杰公司通知將貨送至喬杰公司指定之台中倉庫，又因喬杰公司未依約給付價金，而由上訴人取回貨物，並協議於105年10月17日買回其中3971片，且由鋌鑫公司開立9張支票以為擔保等情，均據提出提貨單、貨運公司收據、雙方簽立之協議書、喬杰公司開立之發票、上訴人聯絡交貨及買回之電子郵件、鋌鑫公司書立之聲明書（有記載9張支票明細）及在取回之支票影本簽收之字據等以為證明，均核屬有據。

⑷據上，上訴人主張其出售半導體模組予喬杰公司，嗣因喬杰公司未依契約履行出貨及給付價金，而由上訴人買回之交易過程，均據提出各該階段對應之文書以為證明，符合事實經過之時間順序，內容至為具體明確，生產製程有關之文書復有權責人員之紀錄與印文，且與電腦記錄之產品項目、規格、工單號碼、生產訂單、裝箱工令所示之產品序列號相符，顯非臨訟杜撰，堪認俱屬真正，而具形式證據力與實質證明力，中華電信公司否認該等文書之真正，尚非可採。

(四)附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物，與附表三所示執行標的物不具同一性

1.中華電信公司會同喬杰公司、鋌鑫公司在上訴人廠區辦理驗收交貨之系爭附條件買賣契約標的物，雖無逐一清點一一記錄各片半導體模組側框編號之紀錄可資比對，但規格型號均為AJP-M660，其中二箱即箱號：CT00000000-000、CZ000000000-000，各箱內半導體模組之序列號如附表二所示（見原審卷289、291頁），比對其內模組序列號，核屬上訴人所提出製令編號：0000-00000000000廠內半成品製造命令備註欄記載之BG000000-BG002799號之範圍，該製造命令之開單日期為105年1月20日（見原審卷第329、331頁），參以中華電

信公司主張其出售鋌鑫公司之系爭附條件買賣標的物半導體模組，係向喬杰公司購買，並於105年4月21日會同喬杰公司、鋌鑫公司在上訴人廠區驗收交貨，並自承雖係105年4月20日始簽立喬杰公司專案契約書，但中華電信公司內部跑契約的流程會比較久，通常都是先跟對方達成合意，而且談妥之後，事後才會補足完整的契約文件等語（見原審卷第95-109頁、本院卷二第113頁），可見中華電信公司在105年4月20日簽訂喬杰公司專案契約之前，就已經進行採購行為，俟商品製造完成確定可驗收交貨，始補簽專案契約，而由上訴人陳述其生產半導體模組之製程，自進貨、備料、檢驗材料、下單製造半成品、再製成成品出貨，顯非數日之短時間可完成，比對上訴人提出附表二之製造命令與中華電信公司於105年4月21日驗收交付鋌鑫公司如附表二所示系爭附條件買賣半導體模組之序列號，附表二所示半導體模組顯然是依上訴人105年1月20日廠內半成品製造命令所製造之商品，由時序上觀察，顯然比較符合上訴人之生產製程。

2.107年4月9日中華電信公司經執行取回之附表三所示執行標的物，仍由中華電信公司占有，雖中華電信公司顧慮模組拆箱後影響價格，本院未能會同兩造逐一拆箱檢視每片半導體模組側框標示之序列號，僅能由中華電信公司將箱外標示之模組序列號拍照後陳報本院（見本院卷一第225-351頁），經與上訴人提出之廠內半成品製造命令比對結果，附表三所示執行標的物之序列號均在上訴人105年4月27日、同年5月11日廠內半成品製造命令所製造之模組序列號範圍（見原審卷第263-266頁），由此可見中華電信公司會同喬杰公司、鋌鑫公司於105年4月21日驗收交貨之系爭附條件買賣標的物，顯然不可能是附表三所示之半導體模組。又中華電信公司與鋌鑫公司雖係106年1月12日始簽立附條件買賣契約，且於當日始向台南市政府申請設定動產擔保交易登記，登記證明書並未逐一記載每片動產擔保標的物之半導體模組序列號，然觀之附條件買賣契約已明確記載係依鋌鑫公司專案編號

WPCD005062號設定附條件買賣動產擔保交易，中華電信公司復自認系爭動產擔保交易標的物係105年4月21日驗收交貨，並有該日驗收簽報單與交貨簽報單可資佐證（見司執卷第25、27頁），堪認附表二所示驗收交貨之半導體模組係附表一所示附條件買賣動產擔保交易標的物之一部分無訛，而附表三所示執行標的物既係105年4月27日、同年5月11日始由上訴人陸續下單生產，此由附表一、二之半導體模組序列號與附表三之半導體模組序批號完全不同，亦可佐證，足證附表三所示之半導體模組與附表一、二動產擔保交易標的之半導體模組顯然不具同一性，而屬不同批製程之產品至明。

3.從而，附表三所示執行標的物與系爭動產擔保交易標的物不具同一性，係屬不同批製程之產品，則上訴人主張附表三所示執行標的物為其所有，且非系爭附條件買賣動產交易標的物，核屬有據，堪可採信。

(五)基上說明，附表三所示執行標的物為上訴人所有，與系爭動產擔保交易標的物不具同一性，既經認定如前，則上訴人主張系爭執行事件誤將附表三所示之半導體模組強制執行取交中華電信公司占有，侵害其所有權，本於民法第767條第1項之規定，請求中華電信公司返還，即為有理由。

六、綜上所述，上訴人主張其為附表三所示執行標的物所有權人，且附表三所示執行標的物非系爭附條件買賣動產擔保交易標的物，本於民法第767條第1項前段規定，請求中華電信公司返還附表三所示執行標的物，於法有據，應予准許，逾此範圍部分之請求（即請求撤銷系爭執行事件之執行程序部分），自屬無據，不應准許。原審就上開應准許部分為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。至上開不應准許部分為上訴人敗訴之判決，並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證

據，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第463條、第385條第1項前段、第79條、第85條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　14　　日

民事第五庭　審判長法　官　吳森豐

法　官　孫玉文

法　官　林逸梅

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提出理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　14　　日

書記官　鄭信邦

【附註】

民事訴訟法第466條之1：

⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

民事訴訟法第466條之2第1項：

上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。

附表一					
附條件買賣契約書動產擔保交易登記標的物明細表（司執卷第7頁）					
名稱	規格及型式	製造商	出廠日期	數量	所在地址
半導體模組	3BB 250W Solar Module 1632*995*40（mm） 250WP 效率15.4%	安集	105年3月	4,075片	台南市○○區○○○路00號（即安集公司廠區）

附表二						
中華電信公司會同喬杰公司、鋰鑫公司驗收交貨之半導體模組其中二箱明細表（原審卷第281-299頁）						
項次	編號	箱號	產品名稱	數量（片）	產品序列號 Serial No.	備註
1		CT00000000-000	半導體模組	13	BG001530 BG001329 BG001325 BG001531 BG001534 BG001537 BG001536 BG001335 BG001337 BG001339 BG002346 BG002151 BG002156 (原審卷第289頁)	廠內半成品製造命令 製令編號：0000-00000000000 生產廠別：M2 安集二廠 開單日期：105.1.20 備註：BG000000-BG002799 （原審卷第329、331頁）
2		CT00000000-000	半導體模組	13	BG001415 BG001416 BG001410 BG001406 BG001637 BG001627 BG001618 BG001644 BG001617 BG001629 BG001632 BG001722 BG001723	

附表三

106年4月9日強制執行事件，中華電信公司取回之半導體模組明細表

項次	編號	箱號	產品名稱	數量（片）	產品序列號 Serial No.	備註
1	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG056228 BG056175 BG056132 ？ BG056073 BG056069 BG056070 BG056105 BG056056 BG055949 BG055950 BG055871 BG056086 ？ ？ BG065788 BG065798 BG065971 BG065949 BG065953 BG065950 BG065895 BG065897 BG065896 BG065898 BG065823 （本院卷一第231-233頁）	1.廠內半成品製造命令 訂單單號：0000-00000000000 生產廠別：M2 安集二廠 開單日期：105.4.27 備註：BG000000-BG055793 （原審卷第263頁） 2.廠內半成品製造命令 訂單單號：0000-00000000000 生產廠別：M2 安集二廠 開單日期：105.4.27 備註：BG000000-BG056293 （原審卷第264頁） 3.廠內半成品製造命令 訂單單號：0000-00000000000 生產廠別：M2 安集二廠 開單日期：105.5.11 備註：BG000000-BG065981 （原審卷第265頁） 4.廠內半成品製造命令 訂單單號：0000-00000000000 生產廠別：M2 安集二廠 開單日期：105.5.11 備註：BG000000-BG066775 （原審卷第266頁） 5.附表三係以中華電信公司108年4月29日陳報數量計算表之箱號為基礎，因所附各箱號照片標示之序列號有部分難以辨識，故以？標示。 6.項次9中華電信公司數量計算表記載數量為8片，但箱號照片標示僅6組序列號（本院卷一第261頁）。 7.項次10中華電信公司數量計算表記載數量為7片，但箱號照片標示之序列號有部分塗黑無法辨識，僅能辨識3組序列號（本院卷一第263頁）。
2	000-0000-000	00000000-000	半導體模組	13	BG065839 BG065842 BG065846 BG055647 BG055658 BG055593 BG055504 BG055594 BG055358 BG055365 BG055368 BG055371 BG055372 （本院卷一第235頁）	

（續上頁）

3	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055842 BG055846 BG055835 BG055840 BG055595 BG055636 BG055641 BG054921 BG054926 BG054913 BG055768 BG055371 BG054904 BG054915 BG054914 BG054916 BG054908 BG055072 BG055069 BG055063 BG055074 BG055067 BG055068 BG055066 BG055075 BG054980 (本院卷一第237、239頁)	
4	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG054955 BG054948 BG054954 BG055364 BG055361 BG054944 BG055362 BG054967 BG054968 BG054970 BG054971 BG054972 BG054974 BG055314 BG055848 BG055844 BG056033 BG055741 BG055759 BG055766 BG055901 BG055877	

（續上頁）

					BG055882 BG055878 BG055850 BG055836 （本院卷一第241、243頁）	
5	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG056255 BG056264 BG056282 BG055932 BG055938 BG056182 BG056174 BG056173 BG056171 BG056149 BG056157 BG056169 BG056168 BG065929 BG065722 BG065974 BG065843 BG066621 BG066435 BG066312 BG066556 BG055988 BG055997 BG056043 BG055855 BG056011 （本院卷一第245、247頁）	
6	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055488 BG055487 BG055469 BG055484 BG054828 BG054931 BG054936 BG054927 BG054928 BG054930 BG054946 BG054943 BG054942 BG065676	

（續上頁）

					BG065673 BG065672 BG065905 BG066738 BG065906 BG065912 BG065913 BG065901 BG065909 BG055592 BG055553 BG055576 （本院卷一第249、251頁）	
7	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	？ ？ BG065624 BG065616 BG065590 BG065591 BG065595 BG065596 BG065598 BG065611 BG065610 BG065697 BG065615 BG054897 BG055016 BG055024 BG055039 BG055035 BG055091 BG055042 BG055589 BG055729 BG055646 BG055720 ？ ？ （本院卷一第253、255頁）	
8	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	？ ？ ？ ？ BG055893 BG055165	

（續上頁）

					BG055896 BG054876 BG055895 BG056220 ？ ？ ？ BG056251 BG056076 BG054812 BG054810 BG054806 BG054804 BG054860 BG054809 BG054854 BG054844 BG054846 BG054797 BG054850 （本院卷一第257、259頁）	
9	000-0000-000	00000000-000	半導體模組	8	BG055650 BG055651 BG065814 BG065709 BG065668 BG065664 （本院卷一第261頁）	
10	000-0000-000	00000000-000	半導體模組	7	BG055548 BG055490 BG055508 （本院卷一第263頁）	
11	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055099 BG055104 BG055108 BG055109 BG055111 BG055112 BG055118 BG055117 BG056082 BG056269 BG056274 BG056273 BG056271	

（續上頁）

					BG055373 BG055369 BG055374 BG055375 BG055376 BG055378 BG055380 BG055385 BG055147 BG065899 BG065916 BG065919 BG065928 （本院卷一第265、267頁）	
12	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055473 BG065627 BG055130 BG065612 BG065594 BG065593 BG065625 BG065629 BG065630 BG065617 BG065634 BG055027 BG055411 BG055065 BG055062 BG055032 BG055317 BG055312 BG054849 BG054853 BG054857 BG054856 BG054799 BG054796 BG054795 BG055316 （本院卷一第269、271頁）	
13	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	22	BG065708 BG065691 BG065706 BG065698 BG065704	

（續上頁）

					BG065703 BG065695 BG055151 BG065770 BG065769 BG065771 BG065755 BG066075 BG065761 BG065759 BG065818 BG065813 BG065817 BG065812 BG065811 BG065809 BG065743 （本院卷一第273、275頁）	
14	000-0000-000	00000000-00? 00000000-00?	半導體模組	26	? ? ? BG055467 BG055573 BG055414 BG055502 BG055516 BG055526 BG055539 BG055424 BG055423 BG065626 ? ? ? ? ? ? ? BG065608 BG065613 BG065621 BG065580 BG065686 BG065689 （本院卷一第277、279頁）	
15	000-0000-000	00000000-000	半導體模組	21	BG055535	

（續上頁）

		00000000-000			BG055956 BG055954 BG055952 BG055957 BG055959 BG055960 BG055961 BG055603 BG055596 BG055761 BG055712 BG055704 BG055705 BG055146 BG055708 BG055715 BG055133 BG055464 BG055671 BG055733 （本院卷一第281、283頁）	
16	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055710 BG055711 BG055714 BG055721 BG055722 BG055723 BG055717 BG055719 BG055715 BG055732 BG055728 BG055737 BG055738 BG055847 BG056031 BG056015 BG055549 BG056016 BG056004 BG056007 BG056021 BG056006 BG056000 BG055999 BG056003 BG056002 （本院卷一第285、287	

（續上頁）

					頁）
17	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055357 BG055329 BG055327 BG055324 BG055308 BG055476 BG055030 ？ ？ BG055303 ？ ？ ？ BG065762 ？ BG065711 BG065699 BG065694 BG065701 BG065720 BG065900 BG065874 BG065879 BG065881 BG065866 BG065890 （本院卷一第289、291頁）
18	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	？ ？ ？ ？ BG055244 BG055210 BG055257 BG055209 BG055228 BG055226 BG055031 BG055087 BG055387 BG055990 BG055843 BG055982 BG056040 BG056137 BG056138 BG056139

（續上頁）

					BG056140 BG056145 BG056147 BG056148 BG056153 ？ （本院卷一第293、295頁）	
19	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055311 BG055279 BG055278 BG055280 BG054807 BG054862 BG054802 BG054845 BG055263 BG055262 BG055260 BG055261 BG055236 BG055785 BG055757 BG055754 BG055743 BG055724 BG055752 BG055750 BG055749 BG055748 BG055745 BG055744 BG055727 BG055739 （本院卷一第297、299頁）	
20	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055790 BG055955 BG055793 BG055946 BG055094 BG055095 BG065954 BG065935 ？ ？ ？ BG065732	

（續上頁）

					BG065772 BG054934 BG055856 BG055857 BG055020 BG055865 BG056100 BG056099 BG056163 BG056164 BG056144 BG056165 BG056195 BG056276 （本院卷一第301、303頁）	
21	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055942 BG055940 ？ BG055892 BG056054 BG055447 BG055429 BG055944 BG055428 BG055427 BG055425 BG055408 BG055755 BG056291 BG056249 BG055110 BG056290 BG056275 BG056268 BG055797 BG056266 BG055687 BG065907 BG056124 BG056098 BG056265 （本院卷一第305、307頁）	
22	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG065756 BG065723 BG056196 BG066133	

（續上頁）

					BG055181 BG055186 BG055182 BG055192 BG055179 BG055190 BG055193 BG054800 BG055163 BG055225 BG054982 BG055013 BG055272 BG055275 BG055301 BG055119 BG055874 ？ ？ ？ ？ ？ （本院卷一第309、311頁）	
23	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055211 BG054870 BG054868 BG054865 BG054866 BG054852 BG054848 BG055581 BG055578 BG055579 BG055569 BG055563 BG055562 BG055213 BG055212 BG055206 BG055205 BG055204 BG055203 BG055202 BG055200 BG055199 BG055198 BG055201 BG055197 BG054871	

（續上頁）

					（本院卷一第313、315頁）	
24	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055295 BG055302 BG055330 BG055402 BG055328 ？ BG055296 BG055297 BG055403 BG055298 BG055299 ？ ？ BG056065 BG056064 BG055831 BG055824 BG055825 BG055828 BG055830 ？ ？ ？ ？ ？ ？ （本院卷一第317、319頁）	
25	000-0000-000	00000000-000 00000000-00?	半導體模組	26	？ ？ BG055638 BG065794 BG065700 BG065705 BG065713 BG065887 BG055580 BG055803 BG056096 BG055980 BG056001 BG056238 BG056230 BG056229 BG056222 BG055812	

（續上頁）

					BG055799 ？ ？ ？ BG054924 ？ ？ ？ （本院卷一第321、323頁）	
26	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG056289 BG056111 BG066528 BG066701 BG065834 BG065828 BG065824 BG065904 BG055740 BG065776 BG055792 BG055446 ？ BG056136 BG056217 BG055858 BG056151 BG056102 BG056115 BG056067 BG056288 BG056059 BG056106 BG056024 BG056008 BG056101 （本院卷一第325、327頁）	
27	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055764 BG055676 BG055763 BG055114 BG055115 BG055679 BG056036 BG056135 BG065583 BG055351	

（續上頁）

					BG055417 BG055196 BG066515 BG054912 BG054907 BG065603 BG065963 BG065886 BG065882 BG065873 BG065876 BG065878 BG065875 BG065908 BG065911 BG065910 （本院卷一第329、331頁）	
28	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG056066 BG055991 BG055771 BG056038 BG056050 BG056053 BG056026 BG055106 BG055969 BG055968 BG055953 BG055788 BG055789 ？ ？ ？ BG055315 BG055313 BG055320 BG055321 BG054798 BG054847 ？ ？ ？ ？ （本院卷一第333、335頁）	
29	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG065669 BG065658	

（續上頁）

					BG065576 BG055460 BG055501 BG055477 BG055443 BG055463 BG055550 BG055541 BG055523 BG055489 BG055512 BG054969 BG056121 BG056123 BG055445 BG055430 BG056079 BG055616 BG056092 BG055590 BG055617 BG055602 BG056084 （本院卷一第337、339頁）	
30	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055450 BG055499 BG055461 BG055472 BG055471 BG055478 BG055480 BG055482 BG055474 BG056009 BG056012 BG055470 BG055497 BG056162 BG056156 BG065922 BG065914 BG065666 BG065647 BG065657 BG065656 BG065654 BG065653 BG065648 BG065640	

（續上頁）

					BG065637 （本院卷一第341、343頁）	
31	000-0000-000	00000000-？ 00000000-？	半導體模組	26	BG065744 BG065849 BG065854 BG065855 BG065847 BG066508 BG054938 BG054940 BG054941 BG054950 BG054947 ？ BG055347 BG055007 BG054898 ？ BG055947 BG055897 BG055849 BG055936 BG055894 BG055282 BG055294 BG055300 BG055307 BG055026 （本院卷一第345、347頁）	
32	000-0000-000	00000000-000 00000000-000	半導體模組	26	BG055742 BG055416 BG055409 BG055599 BG055600 BG066633 BG066634 BG065741 BG065707 BG065730 BG065719 BG065716 BG055736 BG054925 BG065763 BG065760 BG065764	

（續上頁）

					BG065768 BG065944 BG065938 BG065952 BG065955 BG065958 BG065718 BG065710 BG065712 （本院卷一第349、351頁）	